

# 操作简单的BGA拆焊台 触摸屏一键式自动拆焊

产品名称	操作简单的BGA拆焊台 触摸屏一键式自动拆焊
公司名称	深圳市金邦达科技有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	品牌:金邦达 型号:GM-5280 焊台种类:BGA返修台
公司地址	深圳市宝安区固戍崩山工业区4栋4楼
联系电话	86-075527696998 15012665289

## 产品详情

bga返修台gm-5280产品特点

人性化的系统控制

- 工业pc电脑+智能工业控制模块，控制可靠
- windows界面，人性化ui接口设计，方便操作
- 中英文人机界面
- bga焊接拆解过程自动化
- 软件指示bga焊接流程，操作步骤清晰。

精准的温度控制

- 三温区独立控温，智能pid算法，bga焊接温度控制精度达 $\pm 1$
- 软件控制风扇无极调速，无需外接气源
- 海量bga温度曲线存储
- bga温度曲线快速设置和索引查找
- 支持自动温度曲线分析
- 大流量横流扇自动对pcb板进行冷却，防止pcb板变形

## 精密的机械部件

- v型卡槽、异性pcb支架
- x、y方向运动采用精密导轨

## 完善的安全设计

- bga返修台具有风扇失效保护、热电偶失效保护功能
- 超温失效保护、超温快速切断功能
- 软件数值输入校验和限制功能
- 上加热头具有防撞防压保护功能

## 基本功能

- 界面设置“焊接”、“拆解”、“参数设置”等多级菜单，方便人员操作
- bga焊接采用三温区独立控温，第一、二温区可设置8段升(降)温+恒温控制。
- 第三温区大面积ir加热器对pcb板全面预热，以保证膨胀系数均匀板不变形
- 外置4路测温接口实现同时对不同检测点温度的精密检测
- pcb板定位采用v字形槽，定位快捷、方便、准确，满足不同pcb板的定位
- 在拆卸、焊接完毕后采用大流量横流扇自动对pcb板进行冷却，防止pcb板变形，保证焊接效果。

## bga焊接对象

- 本bga返修台适用于任何bga器件及高难返修元器件做bga焊接，包括ccga、bga、qfn、csp、lga、micro smd、mlf
- 适用于有铅和无铅工艺

## bga返修台gm-5280技术参数

类别	项目	规格参数
温度控制系统	加热温区数量	3个独立温区，分为上温区、下温区、预热区
	加热温区功率	上部加热功率：800w下部加热功率：800w红外区热功率：2700w
	加热方式	热风加热，不需要外部气源，风速软件无级调速
	温度控制算法	k型热电偶+智能pid温度闭环精确控制
	温度控制精度	±1
	温度曲线数量	海量
	温度曲线分析	支持温度曲线分析功能
	外置测温端口数量	4个（可扩展）
pcb及bga尺寸	pcb尺寸	max 420x400mm，min 10x10mm
	bga尺寸	2x2—80x80mm

	pcb装夹方式	v型卡槽、pcb支架，并外配万能夹具
	bga吸取方式	内置真空泵，bga芯片手动吸取
控制系统	控制方式	工业pc电脑+工业控制模块
	控制界面	多功能人性化的操作界面，windows xp操作系统
	过程控制	焊接、拆卸过程实现智能化控制
其它参数	机械外形尺寸	600x600x780mm
	重量	50kg
	电源	4300w

#### bga返修台gm-5280随机附件

配件名称	数量	备注
上热风嘴	4	随机附送
下热风嘴	1	随机附送
异性pcb支架	4	随机附送
k型热电偶线	4	随机附送
真空吸盘	10	随机附送
操作说明书	1	随机附送

本产品的品牌是金邦达，型号是GM-5280，焊台种类是BGA返修台，温度调节范围是0-400（ ），适用范围是BGA拆解焊接，输入电压是AC220 ± 10%（V），外形尺寸是600x600x780（mm），重量是50